

半導体／実装基板のめっき・表面処理技術 ー基礎からプロセス・管理まで

1名分料金で
2人目無料セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/260278>

- ◆日時: 2026年02月17日(火) 13:00～17:00
 ◆【アーカイブ配信受講: 2/18(水)～2/25(水)】の視聴を希望される方は、
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/260278A> こちらからお申し込み下さい。
 ◆受講料: 1名につき49,500円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**46,200円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: 特定非営利活動法人 サーキットネットワーク 事務局長 博士(工学) 大久保 利一 氏

【講演の趣旨】

半導体実装基板の製造において、めっきは非常に重要なプロセスです。あまり目立っていませんが、回路導体や層間接続、および部品接合のための端子の表面処理に、半導体側も含めて各種めっき技術が多用されています。めっきは、「液中に分子単位の大きさで存在する金属イオンを還元して析出させる」もので、極めて微細なパターン形成など、レジストの精度によって次世代の要求特性にも対応し得るポテンシャルを持つ技術なのです。これまでも重要な基盤技術で、製造でめっきの不具合、例えばビアフィリング不良などが起こると、製品の品質や収率に大きな影響があるため、既存製品でのプロセス管理が重要です。そして、今後はさらにAI用等次世代半導体の進化に伴う実装基板の技術発展により、要求特性に対してめっき技術もレベルアップが望まれます。このセミナーでは、代表的な既存および次世代の半導体実装基板と、そこで使われる各種めっき技術の基礎、および今後レベルアップすべき課題について解説します。

【プログラム】

1. はじめに

- 1-1 「めっき技術」の展望
 1-2 各種半導体実装基板で用いられるめっき技術

2. いろいろな半導体実装基板と製造プロセス

- 2-1 既存の半導体実装基板
 2-2 最近登場の半導体実装基板

3. 導体形成のための銅めっき

- 3-1 導体形成のプロセス
 3-2 電解銅めっき
 3-2-1 電解銅めっき設備
 3-2-2 電解銅めっき液
 3-2-3 添加剤、フィルドビア
 3-2-4 めっき液の管理方法
 3-3 無電解銅めっき

- 3-3-1 無電解めっきの原理
 3-3-2 前処理プロセス
 3-3-3 無電解銅めっき液
 3-3-4 フルアディティブプロセス
 3-4 銅めっき皮膜の機械的特性

4. 電流密度分布(めっき膜厚分布)

- 4-1 電流密度分布の理論
 4-2 膜厚均一化の手法

5. 接合のための表面処理

- 5-1 表面処理の目的
 5-2 各種電解めっき
 5-3 各種無電解めっき

6. おわりに これからの動向

『半導体・実装基板めっき【WEBセミナー】』セミナー申込書

※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒☐LIVE/☐アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール ☐郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>